

TEAM-300

全自動フィルム貼付装置

Full-Automatic film Laminator (Lining Type)

【概要 - Outline -】

◆本装置はフィルムのラミネートをウェーハ内周に全自動で行う装置です。

This machine is for laminating the film inside the circumference of a wafer.

【特長 - Features -】

◆多彩なフィルムに対応可能。

Correspondence to various kind of film.

◆ドライレジストフィルム化する事により従来のウェットレジスト工程でのレジスト液の無駄を大幅に軽減できます。

Dry-resist film saves resist solution drastically in the conventional wet resist process.

◆ウェーハ内周に設定したフィルムサイズにカットする事で、メッキ電極に対応してウェーハ周辺部を露出する事が出来ます。

Cutting film smaller allows the exposed area on a wafer edge part in accordance with the plate electrode.

◆真空状態でフィルムとウェーハを貼付けることにより、気泡の発生が無くウェーハにダメージを与えません。

Laminating film in a vacuum chamber prevents bubbles on the film as well as damages to the wafer.

◆フィルムはノンテンション方式にてストレスなく貼付けます。

Film is laminated in the manner of non-tension avoiding any stress.

◆前工程向けクリーン対応。(オプション)

Clean capability for front-end process.(option)



仕様 Specification		TEAM-300
スループット Throughput		フィルム及びご使用条件により異なります Depend on the film type & the machine parameter
対応ウェーハサイズ Wafer Size		12 inch (8 inch)
使用フィルム幅 Film Width		12 inch : 330 ~ 360mm
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC200V 三相 (three phase) 50 / 60Hz 3.0KVA
	空気源 air	圧力 (pressure) 0.5~0.8Mpa 400NI/min (ANR)
	真空源 Vacuum source	-74Kpa
装置寸法 Dimension		D 2,250×W2,100×H2,300 mm (シグナルタワー含まず Excluding signal tower)
重量 Weight		1,200kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.